

SMT Single Pair Ethernet Buchse, stehend, Einbau in Verbindung mit 661-4 SMT Single Pair Ethernet Buchse, vertical, for assembly with 661-4

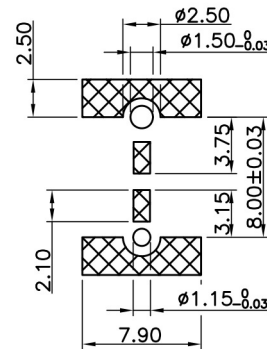
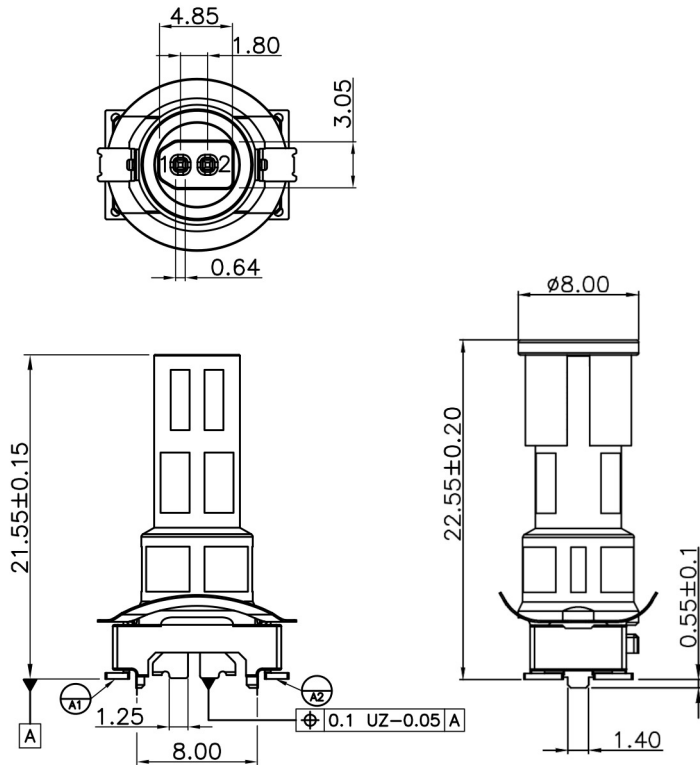
Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing vernickelt, Gummi, Mutter: Edelstahl
Shell	Nickel plated brass, Rubber, Nut: Stainless steel
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper Alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold plated over nickel
Oberfläche Lötanschluss	Mattzinn über Nickel
Plating Solder Side	Matte tin plated over nickel
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Test Voltage	1 kV DC
Nennspannung	72 V DC
Voltage Rating	72 V DC
Nennstrom	4 A
Current Rating	4 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Temperature Range	-40 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

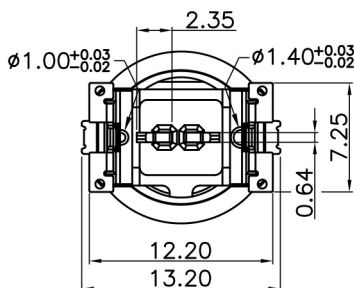


© W+P PRODUCTS

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
Data Transfer Ratio: 1 Gbit/s



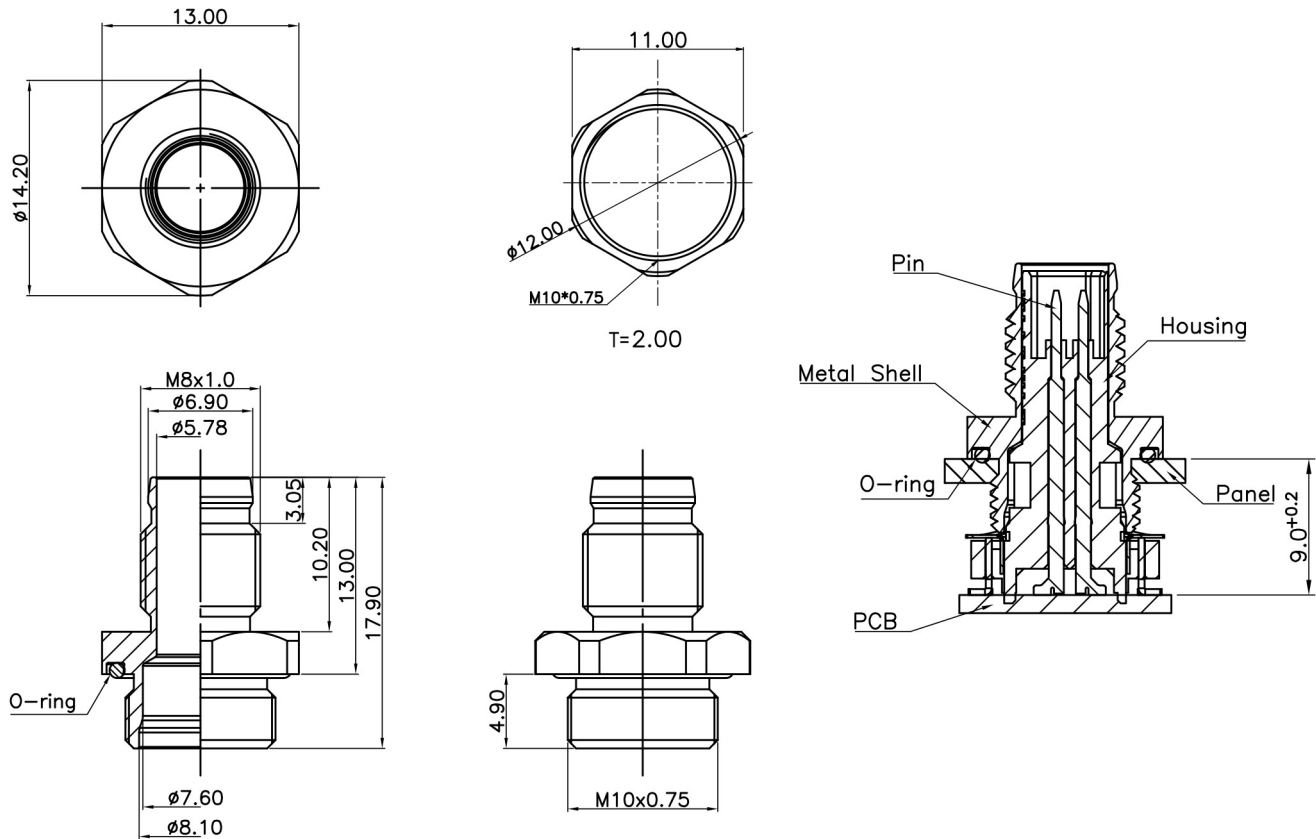
PCB Layout



Series	Design	Contacts	Type	Packaging	Version
6610	5	02	3	PPTR	093
	5 M8 (entsprechend IEC 63171-5) M8 (in accordance with IEC 63171-5)		3 Stiftkontakte Male contacts	PPTR	

6610

SMT Single Pair Ethernet Buchse, stehend, Einbau in Verbindung mit 661-4
SMT Single Pair Ethernet Buchse, vertical, for assembly with 661-4



Series

661-4

Type

M8

M8 Messinggehäuse für M8-Anschluss
Brass housing for M8 connection
MS Mutter M10x0.75 (Edelstahl)
Nut M10x0.75 (stainless steel)

Assembly Type

1010

1010 Vorderwandmontage, Rundloch, M10x0.75
(Nur für Gehäuse)
Front mounting, round hole, M10x0.75
(For housing only)

Lieferformen / Packaging Options:

PPTR Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

